

<<电子产品工艺>>

图书基本信息

书名：<<电子产品工艺>>

13位ISBN编号：9787111300618

10位ISBN编号：7111300610

出版时间：2010-6

出版时间：机械工业出版社

作者：樊会灵 编

页数：154

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电子产品工艺>>

内容概要

本书是普通高等教育“十一五”国家级规划教材，是为高职高专电子信息类专业编写的电子工艺基础教材。

内容包括：常用电子元器件、印制电路板的设计与制作、焊接工艺、电子产品的防护与电磁兼容、整机装配工艺和电子产品的调试与检验。

书中详细介绍了新型元器件、新的焊接材料及焊接工艺、新产品的调试方法、ISO9000标准系列等。

本书以加强实践能力的培养为目标，考虑到电子工艺的发展，突出新工艺和实用性，兼顾基础知识，概念清楚、重点明确，在内容的编排上充分考虑了教学的需求。

本书也可供相关工程技术人员参考。

书籍目录

第2版前言第1版前言第一章 常用电子元器件 第一节 电阻器和电位器 第二节 电容器 第三节 电感器 第四节 半导体器件 第五节 电声器件、光电器件和压电器件 第六节 片状元器件 本章小结 习题一第二章 印制电路板的设计与制作 第一节 印制电路板的结构与种类 第二节 印制电路板设计的基本原则 第三节 手工制作印制电路板 第四节 Protel 2004电路板设计软件简介 本章小结 习题二第三章 焊接工艺 第一节 焊接的基本知识 第二节 无铅焊料 第三节 手工焊接技术 第四节 无铅助焊剂 第五节 自动焊接技术 第六节 无铅焊接的工艺技术与设备 第七节 表面安装技术 本章小结 习题三第四章 电子产品的防护与电磁兼容 第一节 电子产品的防护与防腐 第二节 电子产品的散热 第三节 电子产品的防振 第四节 电子产品的电磁兼容性 第五节 电子产品的静电防护 本章小结 习题四第五章 整机装配工艺 第一节 整机装配的准备工艺 第二节 电子产品工艺文件 第三节 电子产品装配工艺要求及过程 本章小结 习题五第六章 电子产品的调试与检验 第一节 调试工艺 第二节 检验 第三节 电子产品的质量管理及ISO 9000标准系列 本章小结 习题六参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>